



VIEW A (SCALE:1:1)

△6	△4	178308-5
△6	△3	178308-3
△6	△2	178308-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

METRIC

NUMBER 178308

3rd ANGLE PROJECTION

推奨基板取付け穴寸法
PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
 - めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

					Copyright © 1993 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
C1	REVISED	ECR-07-013273	TS	DM	11/20/93	WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
C	REVISED	(FJD0-0039-03)	TS	S.M	6/2/03	mm(AWG)	mmφ	ダイナミック D3100 水平タイプ 20 極 ヘッダーアセンブリー
B	REVISED	(FJD0-0114-03)	TS	SM	25/APR/03	MATERIAL	FINISH	20 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100
A	REVISED	(FJ00-2183-95)	K.I	SM	3/23/95	SEE NOTE 注記参照	SEE NOTE 注記参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
O	RELEASED	(FJ00-0017-93)	Y.T	S.M	2/8/93	DR. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	DE. 20-JAN-'93 Y.TANAKA	100% 300F : ±0.3 300% 1000F : ±0.4 角 度 : ±3'
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE	CHK. 8-FEB-'93 S.MANABE	APP. 8-FEB-'93 S.MANABE	SIZE LOC NUMBER A3 J C-178308
								SCALE 2-1 REV C1 SHEET 1 OF 1